



証券コード：2760

Connect Beyond

企業IR & 個人投資家応援イベント  
**半導体とIT、モノづくりシステムで  
DX社会に貢献する  
VISION2025が始動**

2022年2月19日（土）  
東京エレクトロン デバイス株式会社  
代表取締役社長 德重 敦之



# 本日の内容

- 会社概要
- 業績見通し
- 将来の成長への取り組み –中期経営計画VISION2025–
- 配当政策



# 会社概要

# 会社概要



**設立年月日** 1986年3月3日

**本社所在地** 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア

**資本金** 24億9千5百万円

**売上高** 1,432億円（2021年3月期）

**従業員数** 連結 1,247名（2021年3月31日現在）

**拠点・グループ** 国内 18拠点、子会社 7社、関連会社 1社



# 当社のあゆみ



- 1965年 東京エレクトロン株式会社で電子部品ビジネスを開始
- 1998年 東京エレクトロン株式会社から 電子部品事業  
(現 : 半導体及び電子デバイス事業) を全て譲受け
- 2003年 東京証券取引所 市場第2部上場
- 2006年 東京エレクトロン株式会社から コンピュータネットワーク事業  
(現 : コンピュータシステム関連事業) を承継
- 2010年 東京証券取引所 市場第1部上場
- 2017年 株式会社アバール長崎 (現 : 東京エレクトロン デバイス長崎株式会社) を連結子会社化
- 2018年 株式会社ファーストを連結子会社化

# 事業内容

Connect Beyond

最先端の半導体やITシステムなどを提供する **専門商社**  
**メーカー機能** 強化を推進

## CN 事業

コンピュータシステム関連事業



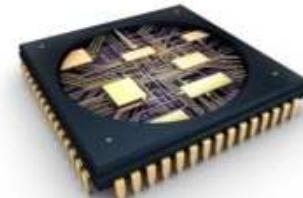
ITインフラ機器 セキュリティソフトウェア



IT保守・監視サービス

## EC 事業

半導体及び電子デバイス事業



半導体



基板（ボード）

## PB 事業

プライベートブランド事業



設計・量産受託サービス



プライベートブランド製品

# 事業セグメント

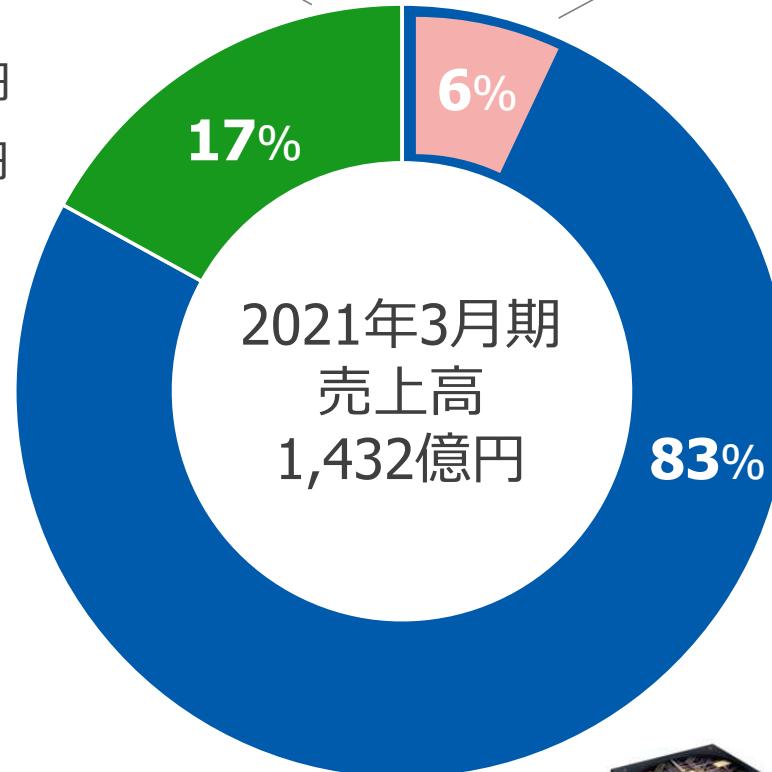
## CN 事業

売上高 239億円  
セグメント利益 28億円



主な販売先

- システム会社
- データセンター
- 官公庁
- 一般企業



## PB 事業

売上高 92億円※



## EC 事業

売上高 1,193億円  
セグメント利益 17億円



主な販売先

- 電子機器メーカー
- 産業機器メーカー
- 自動車関連メーカー



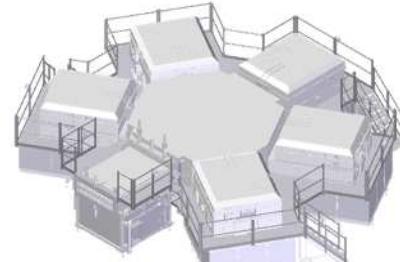
半導体/フラットパネルディスプレイ  
製造装置メーカー

## 東京エレクトロン

半導体製造装置事業



フラットパネルディスプレイ  
製造装置事業



専門商社  
**東京エレクトロンデバイス**

半導体及び電子デバイス  
(EC) 事業



コンピュータシステム関連  
(CN) 事業



- EC事業とCN事業が分離・独立
- 東京エレクトロンの出資比率は33.82%
- 東京エレクトロンの持分法適用関連会社

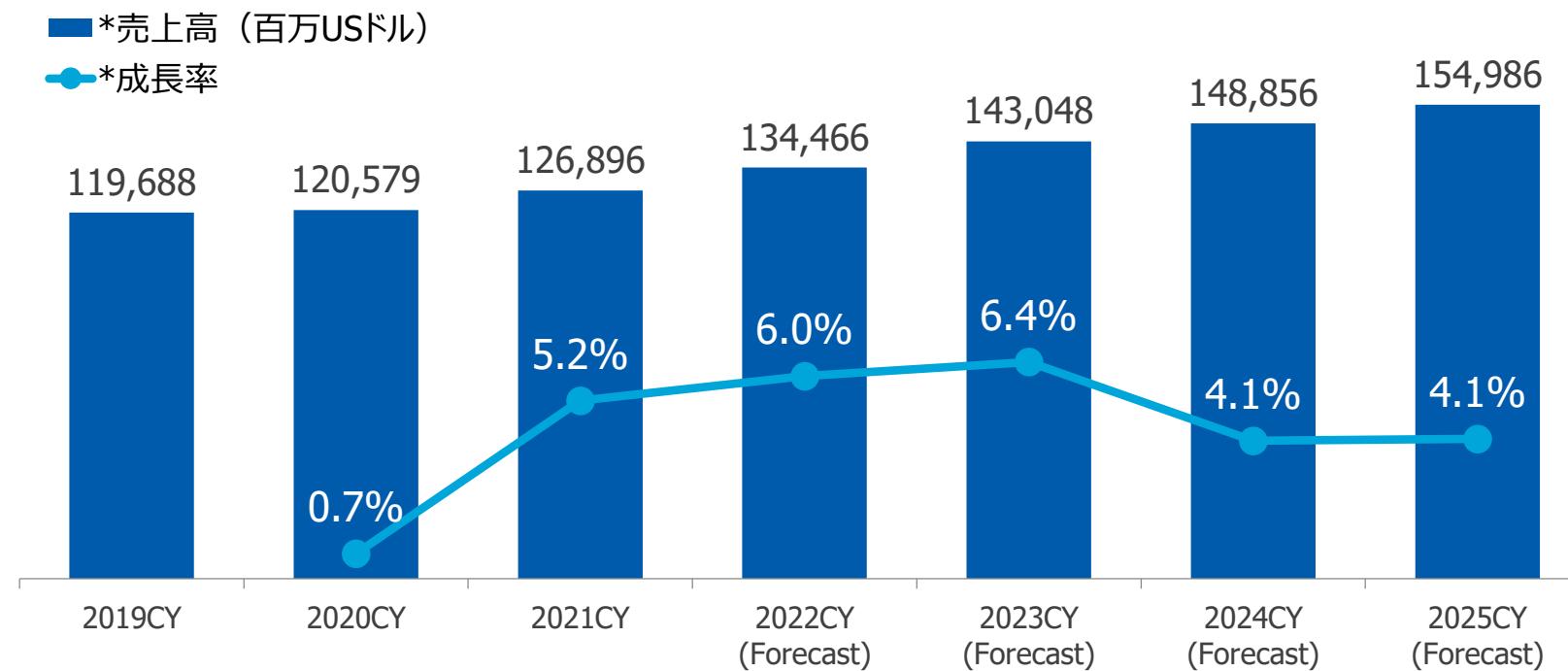


# 業績見通し

# 国内ITサービス市場予測

Connect Beyond

- 2022年は前年比+6.0%の成長を予測
- 2020年～2025年の年間平均成長率は5.1%と予測

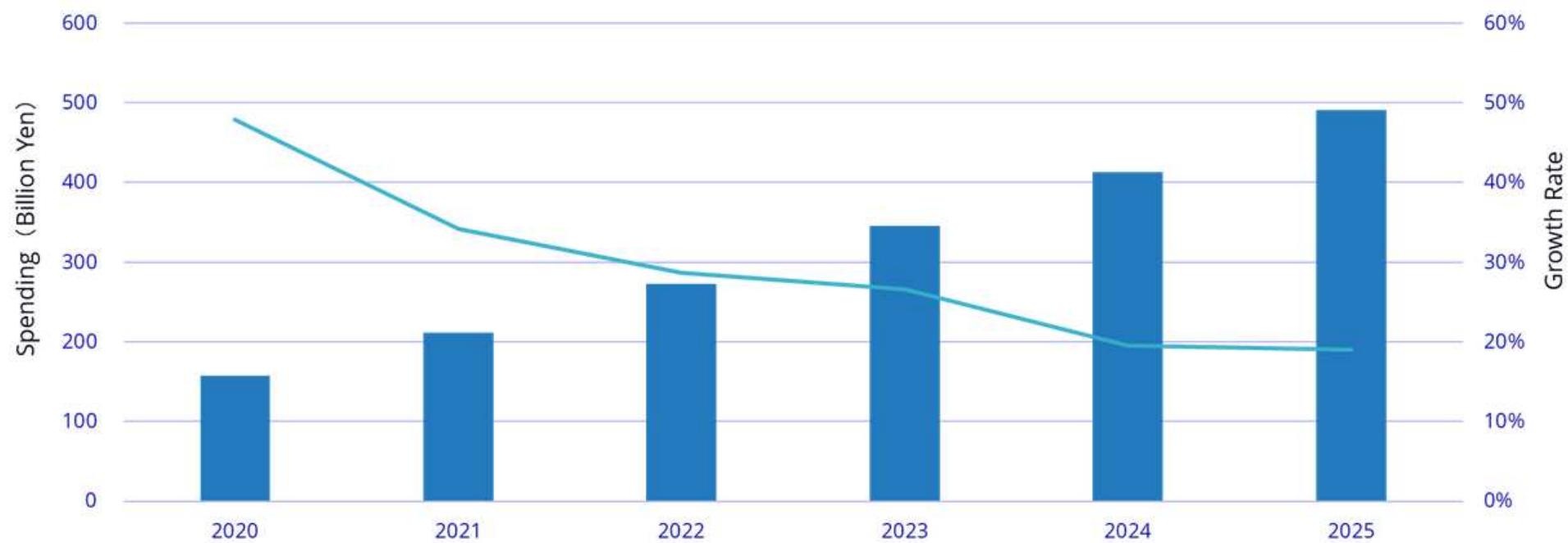


出典：グラフはGartner リサーチに基づき東京エレクトロンデバイスが作成。Gartner, Forecast: IT Services, Worldwide, 2019-2025, 4Q21 Update, Colleen Graham et al., 21 December 2021, \*売上高, 成長率 = Based on End-User Spending Constant Currency basis.

# 国内AIシステム市場予測

Connect Beyond

- 2022年は前年比+28.7%と成長が継続するものと予測
- 2020年～2025年の年間平均成長率は25.5%と予測

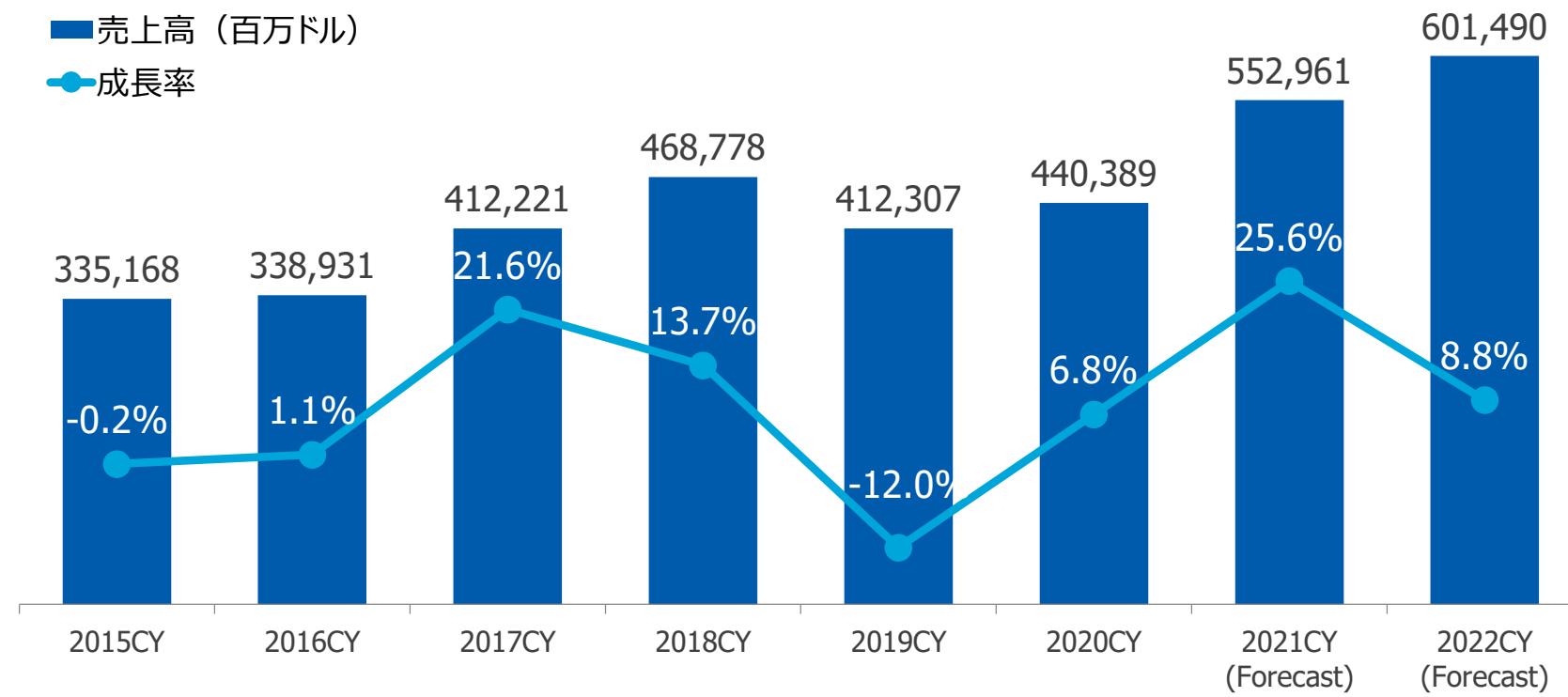


出典： IDC Japan プレスリリース  
「国内AIシステム市場予測を発表」 2021年6月2日

# WSTS 2021年秋季半導体市場予測

Connect Beyond

- 2022年は前年比+8.8%と予測
- 2022年の国内市場は 前年比+10.3%の約5兆2,395億円と予測



出典： WSTS（世界半導体市場統計）  
「WSTS 2021年秋季半導体市場予測について」 2021年11月30日

# 2022年3月期 当社事業環境



- 新型コロナウイルス感染による影響
  - 鎮静化には時間要するが 多くの製造業では先行して回復
- 米中間の対立
  - 対立が長期化し 融和による 経済活動の好転は期待できない
- データ通信量の増大
  - DX化の進展などにより 通信量の増加傾向が続く
- 半導体の需給状況
  - 逼迫感は継続
  - 当社は上期と同水準の商材供給を維持

# 2022年3月期 業績見込み

Connect Beyond  
(百万円)

	2021年3月期	2022年3月期	対前年比		2022年3月期	
	通期	通期予想	増減額	増減率	1-3Q実績	通期予想進捗率
売上高	143,268	172,000	28,731	20.1%	127,892	74.4%
CN事業	23,933	23,800	▲133	▲0.6%	15,479	65.0%
EC事業(連結)	119,334	148,200	28,865	24.2%	112,412	75.9%
EC事業	110,129	138,100	27,970	25.4%	105,704	76.5%
PB事業	9,205	10,100	894	9.7%	6,708	66.4%
経常利益 (利益率)	4,625 (3.2%)	6,200 (3.6%)	1,574	34.0%	4,260	68.7%
当期純利益 (利益率)	3,143 (2.2%)	5,200 (3.0%)	2,056	65.4%	3,895	74.9%

※ 当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益

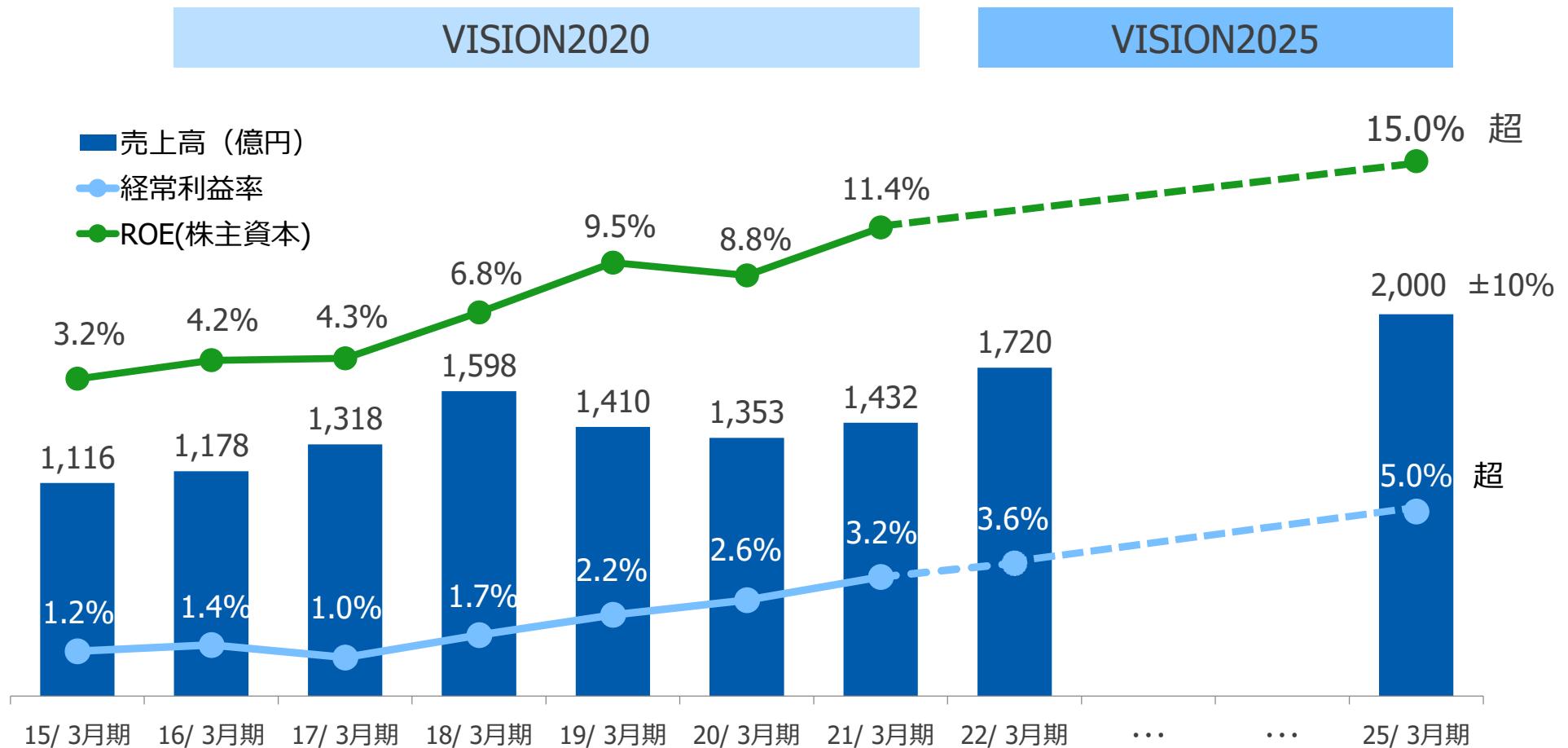
※ 2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用するため、上記の連結業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっております



# 将来の成長への取り組み —中期経営計画VISION2025—

# 中期経営計画

Connect Beyond



# 中期経営計画 VISION2025



## 想定する事業環境

### Society 5.0 の到来

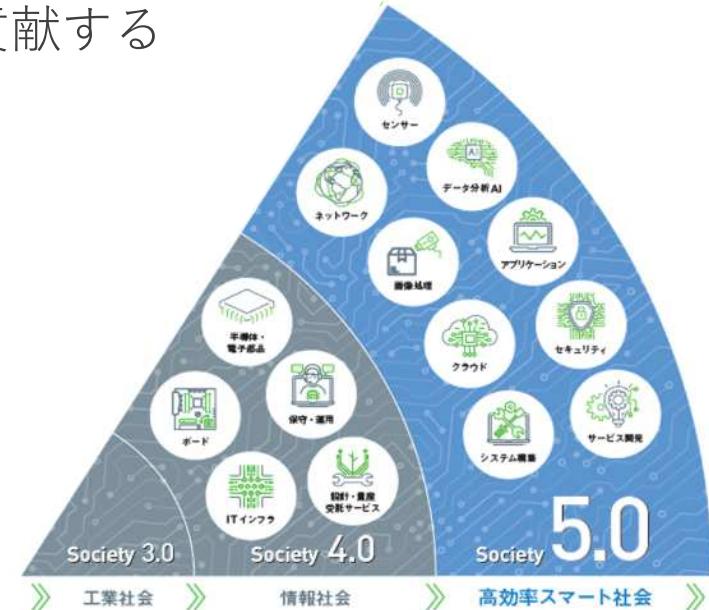
低成長経済下における  
高効率スマート社会



## 当社のMISSION

### DRIVING DIGITAL TRANSFORMATION

デジタルトランスフォーメーションを  
実現する製品・サービスを提供し  
高効率スマート社会の持続的発展に  
貢献する



## 当社のVISION

### 技術商社機能を持つメーカーへ

#### 進化する技術商社機能

- データ・サービス・ストックビジネスを利益源泉とするビジネスモデル
- メーカー事業の成長に資する顧客基盤の維持・拡大
- 安定的な利益基盤の構築

#### メーカーとして目指す形

- モノづくりシステムメーカー
- ODMメーカー
- 課題解決型の設計開発部門
- 高効率スマート工場

## 増益增收（増益率>增收率）による持続的成長を目指す

2025年3月期

- 売上高 2,000 億円 ±10%
- 経常利益率 > 5 %
- ROE (株主資本) > 15 %

	売上高構成比	経常利益率
CN事業	20 %	> 13 %
EC事業	70 %	> 2 %
PB事業	10 %	> 10 %

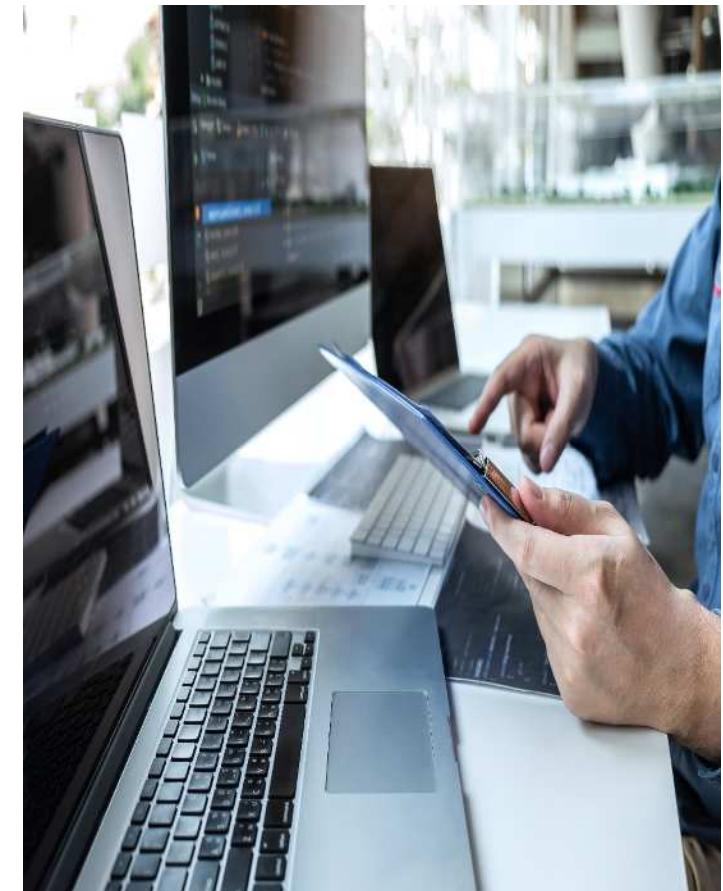
## 基本方針

- 成長市場に対する最先端技術製品  
およびサービスの提供による利益成長
- 事業多様化による持続的成长



## **CN事業** ITセグメント

- 最先端製品によるIT需要の取り込み
- ストック型 保守・監視サービスの提供
- サブスク型 DXサービスの提供



# 成長戦略 CN事業 取り組み



## 最先端製品によるIT需要の取り込み

セキュリティ製品販売の強化

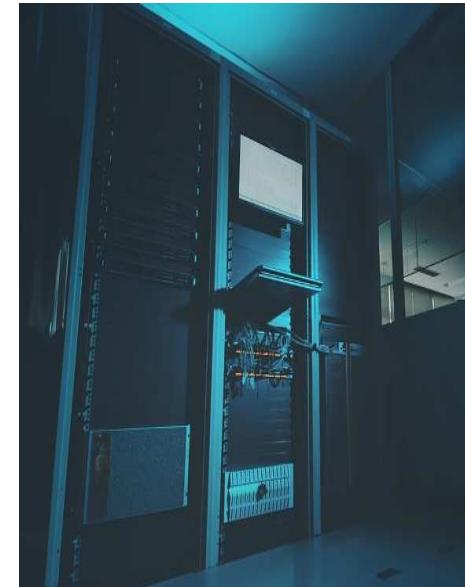
ゼロトラストセキュリティへのニーズに対応



## サブスク型 DXサービスの提供

TED AI Lab（ラボ）を始動

AI 実証実験サービス提供を本格化



## EC事業 半導体セグメント

- 車載・産業機器市場の商権拡大による半導体需要 取り込み
- クラウドビジネスの推進
- 設計・量産受託サービス（DMS）を付加した製品の販売

※DMS（Design & Manufacturing Service）  
顧客指示に基づき製品を設計製造するサービス



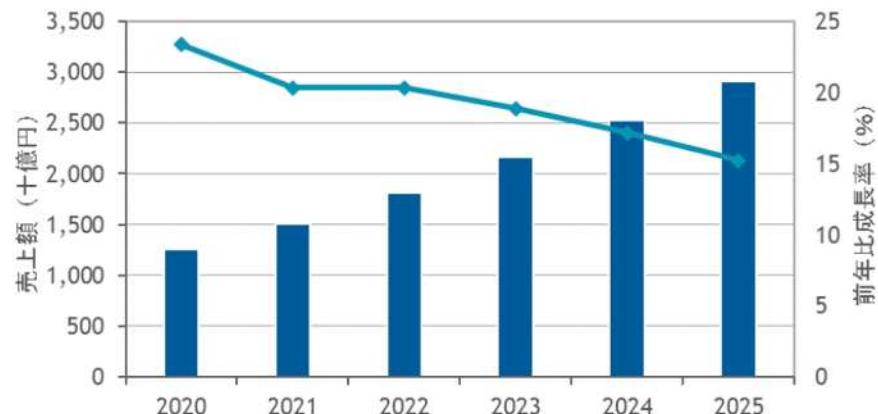
## クラウドビジネスの推進

### Microsoft Azure ビジネスを展開

- DXを支えるパブリッククラウド需要に対応
- ストック型ビジネス
- マイクロソフト社認定 クラウド ディストリビューター

### 国内パブリッククラウドサービス市場 売上額予測 2020年～2025年

- 2021年は 前年比20.3%増の1兆5,087億円になると予測
- 2025年は2020年比2.3倍の2兆9,134億円になると予測
- 2020年～2025年の年間平均成長率は18.4%と予測



出典： IDC Japan プレスリリース  
「国内パブリッククラウドサービス市場予測を発表」 2021年10月4日

## **PB事業** 製造自動化セグメント

- モノづくりシステム開発への注力
- 開発受託製造（ODM）への移行

※ODM (Original Design Manufacturing)  
独自に開発製造した製品を他社ブランドで提供するビジネス



## モノづくりシステム開発への注力（ヒト機能の置き換え）

マクロ検査装置 「RAYSENS」

化合物半導体ウェハ 自動検査装置

3Dビジョンロボットシステム 「TriMath」

不定形物を扱う作業ロボットシステム



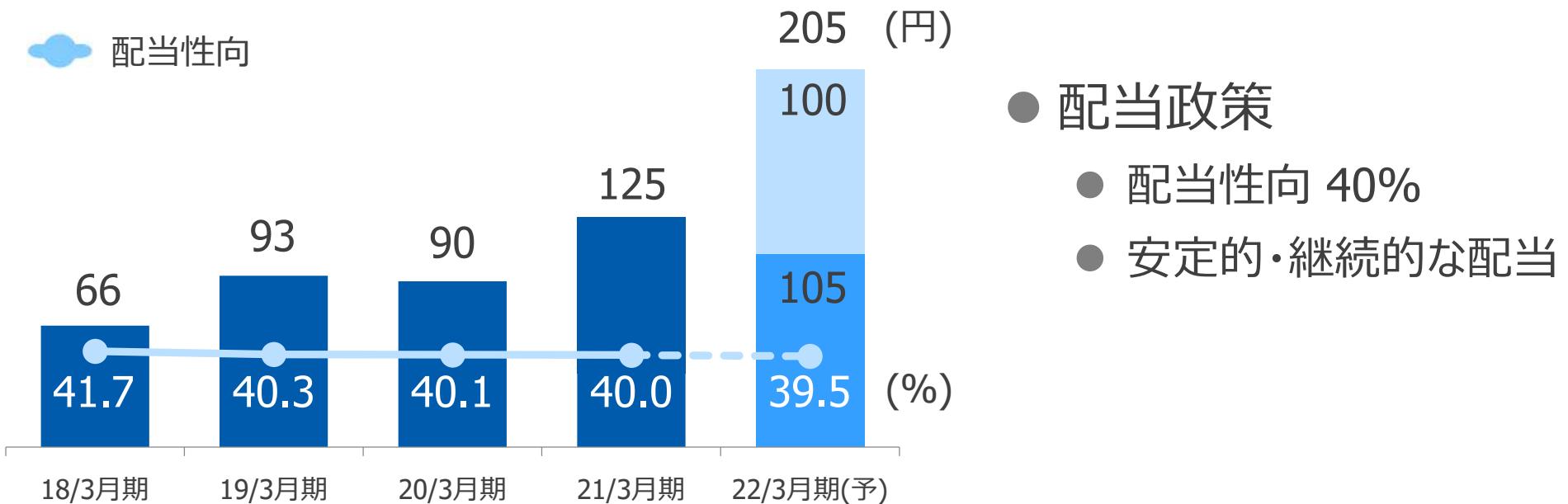


# 配当政策

# 1株当たり配当金

Connect Beyond

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	増減額
中間	40円	40円	105円	65円
期末	50円	85円	(予定) 100円	(予定) 15円
年間	90円	125円	(予定) 205円	(予定) 80円





ご清聴ありがとうございました

弊社のIRサイトもご覧ください  
<https://www.teldevice.co.jp/ir>

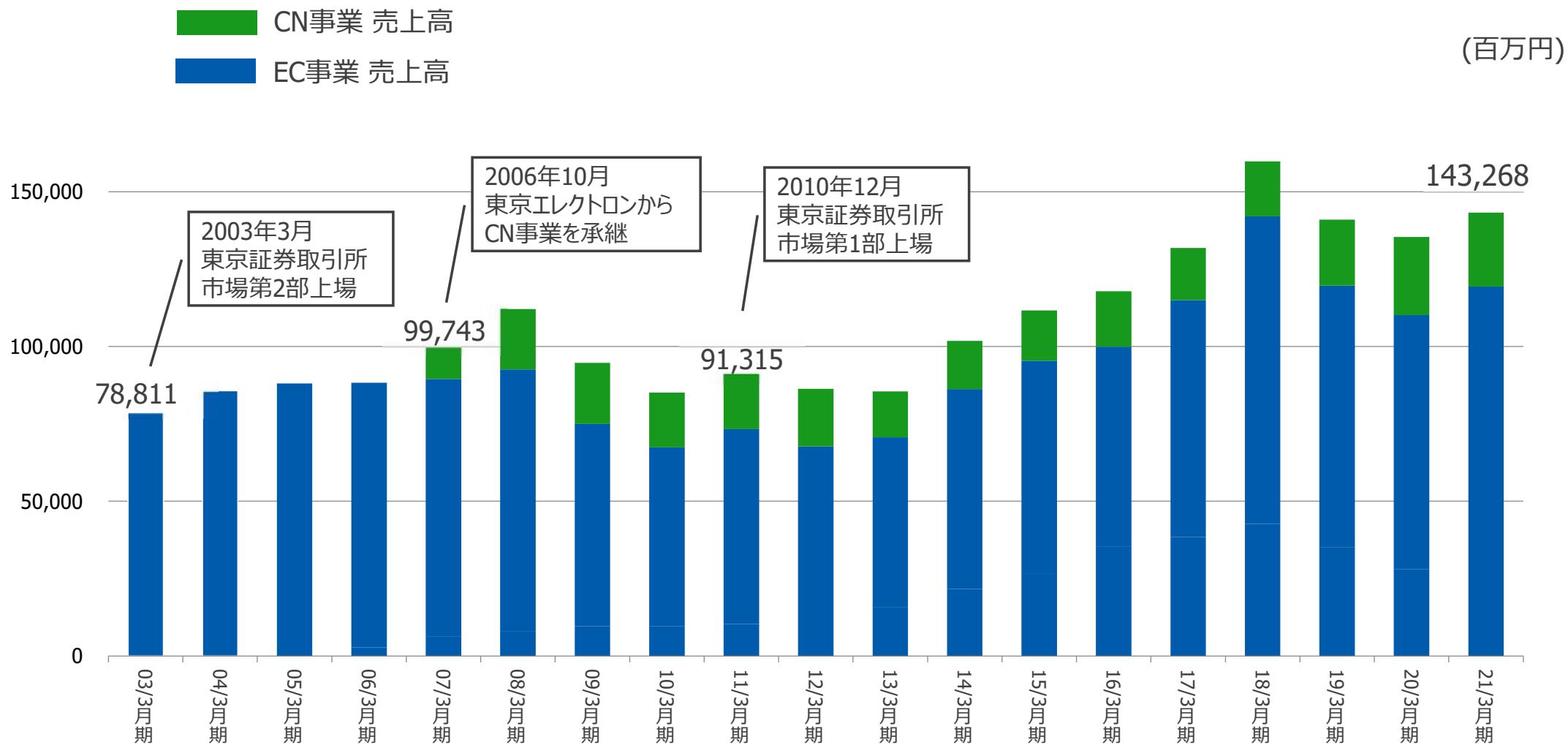


# 参考資料



- 連結業績推移
- 連結損益計算書
- 連結貸借対照表
- 海外連結子会社 売上高推移
- 経営指標
- EC事業 仕入先・販売先
- CN事業 仕入先
- 国内の主な専門商社
- 株式の状況

# 参考資料：連結業績推移



# 参考資料：連結損益計算書



(百万円)

	2020年3月期	2021年3月期	対前年比	
			増減額	増減率
売上高	135,394	143,268	7,873	5.8%
売上総利益	19,902 (14.7%)	20,601 (14.4%)	699	3.5%
営業利益	3,810 (2.8%)	4,620 (3.2%)	810	21.3%
経常利益	3,573 (2.6%)	4,625 (3.2%)	1,051	29.4%
当期純利益	2,288 (1.7%)	3,143 (2.2%)	854	37.3%
1株当たり当期純利益	224 円 44 銭	312 円 38 銭		
従業員数	1,216 名	1,247 名		

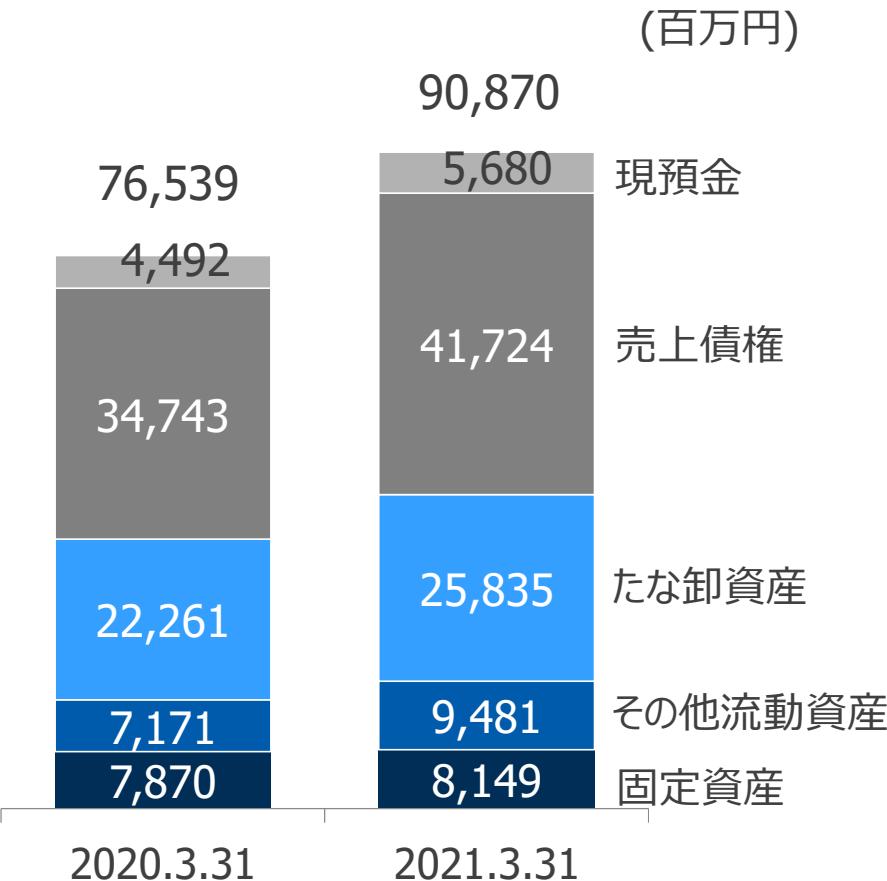
※ ( ) 内は利益率

※ 当期純利益は  
親会社株主に帰属する当期純利益

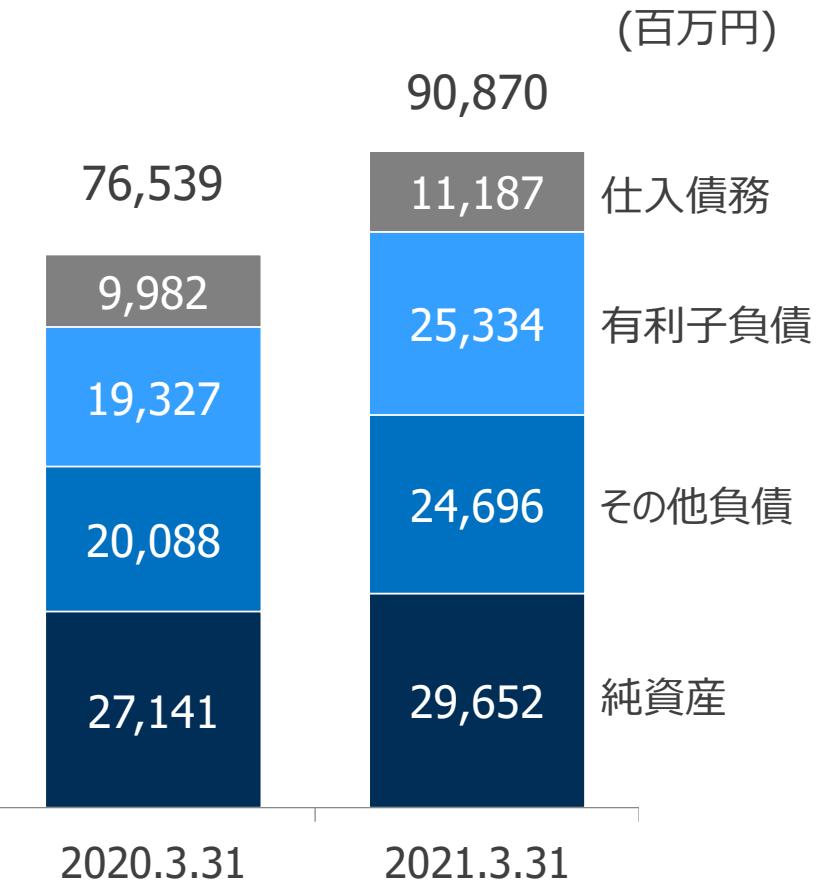
# 参考資料：連結貸借対照表

Connect Beyond

## 資産

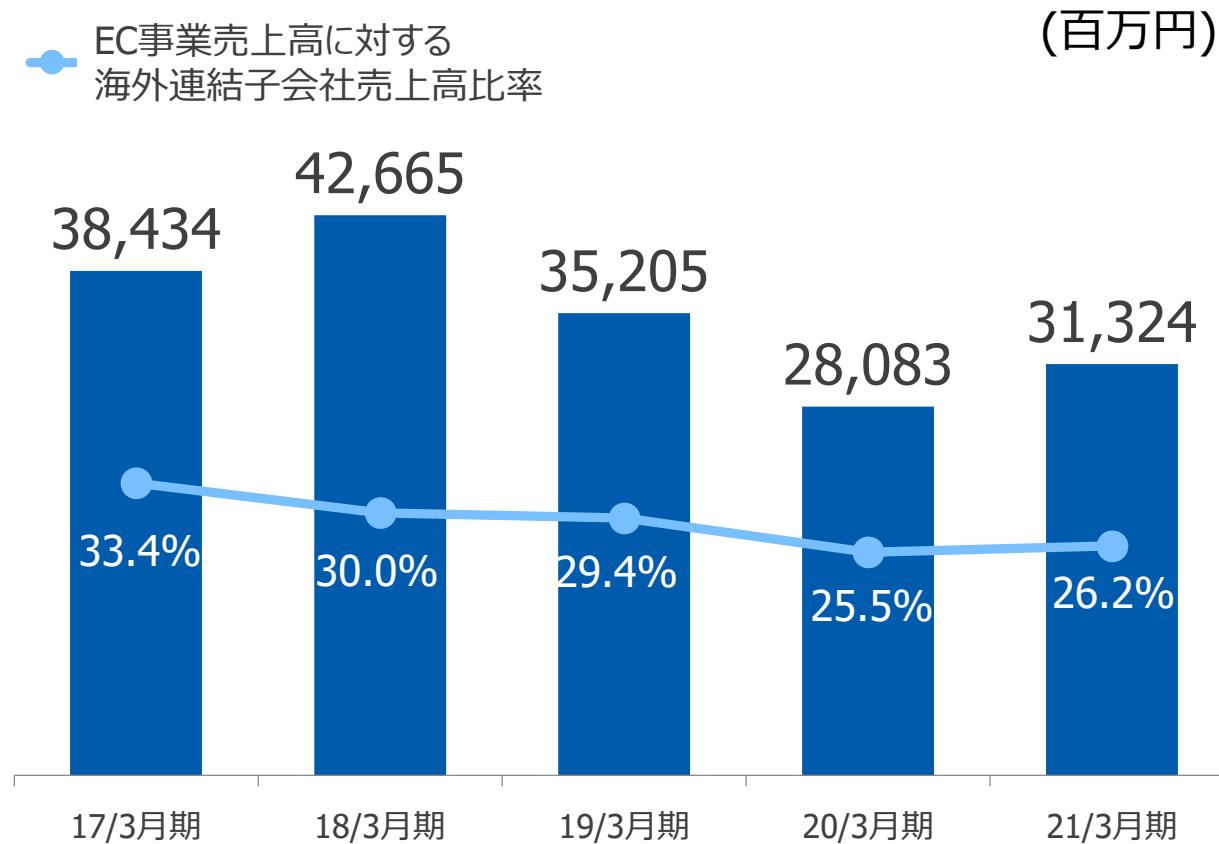


## 負債・純資産



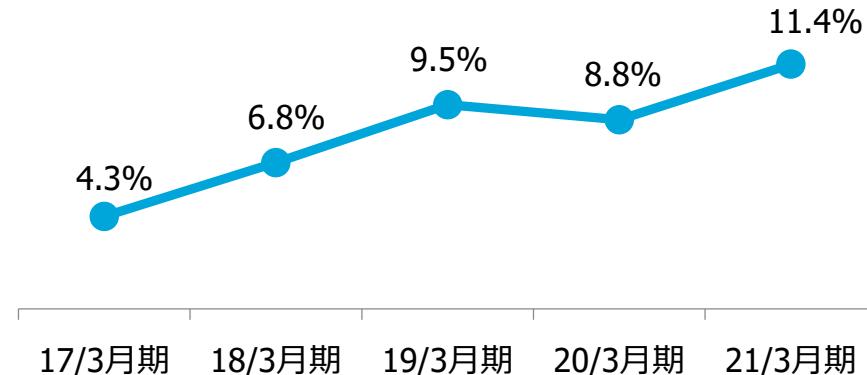
# 参考資料：海外連結子会社 売上高推移

Connect Beyond

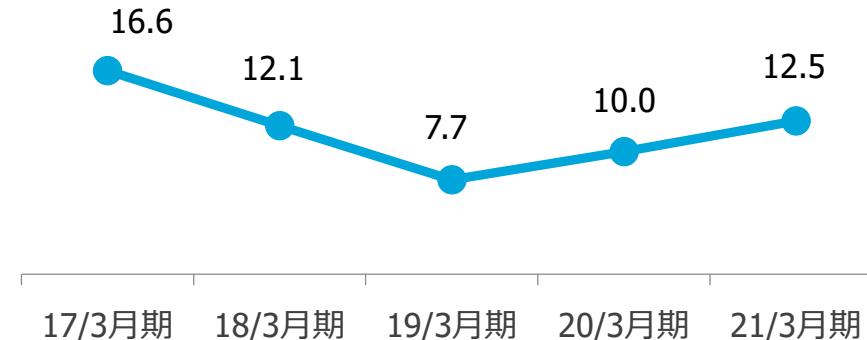


## 參考資料：經營指標

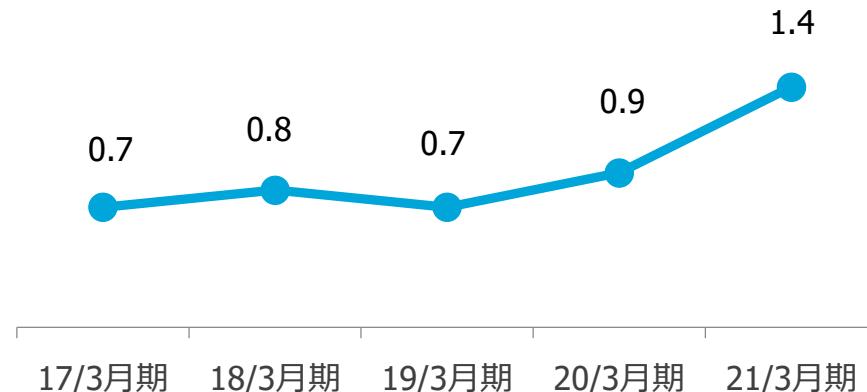
株主資本当期純利益率 ROE (%)



株価収益率 PER (倍)

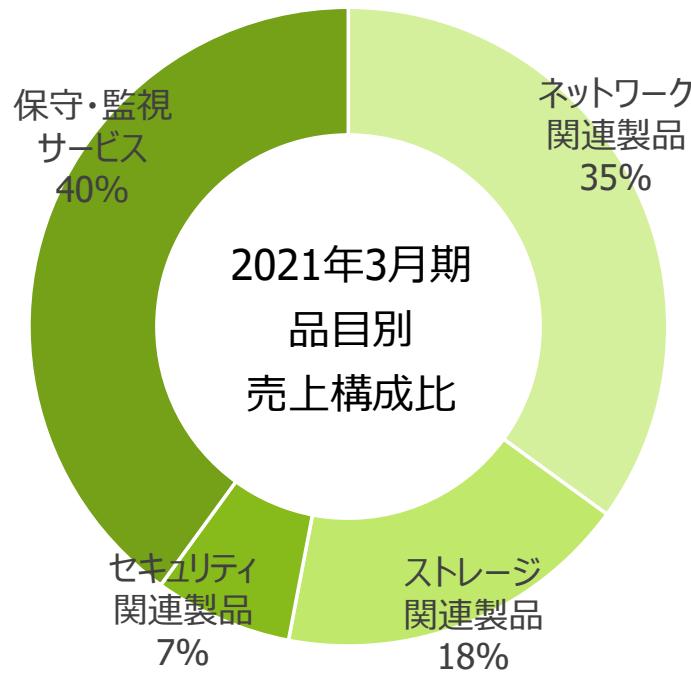


株価純資産倍率 PBR (倍)



※ 株主資本当期純利益率 (ROE) =  
 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均株主資本  
 ※ 株価収益率 (PER) = 期末株価 ÷ 一株当たり当期純利益  
 ※ 株価純資産倍率 (PBR) = 期末株価 ÷ 一株当たり純資産

# 参考資料：CN事業 品目別売上高構成比

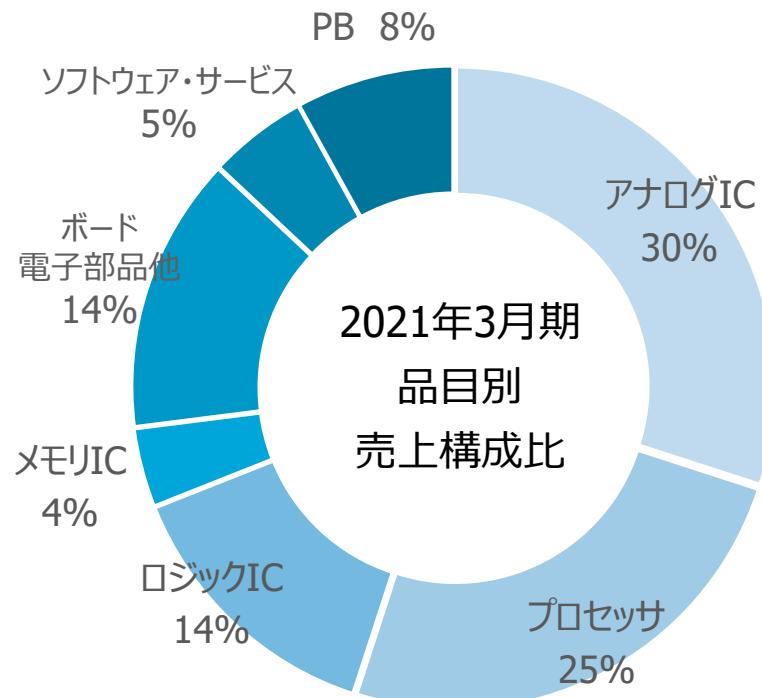


ソリューション	主な製品	主な仕入先
ネットワーク 関連製品	ネットワーク負荷分散装置 イーサネットスイッチ	● F5ネットワークス社 ● アリスタネットワークス社
ストレージ 関連製品	フラッシュストレージ	● ピュアストレージ社 ● デル・テクノロジーズ社
セキュリティ 関連製品	エンドポイント ネットワーク クラウド	● ニュータニックス社 ● ネットスコープ社
保守・監視 サービス	機器保守サービス セキュリティ監視サービス	

※主な仕入先は敬称を省略しております。

# 参考資料：EC事業 品目別売上構成比

Connect Beyond



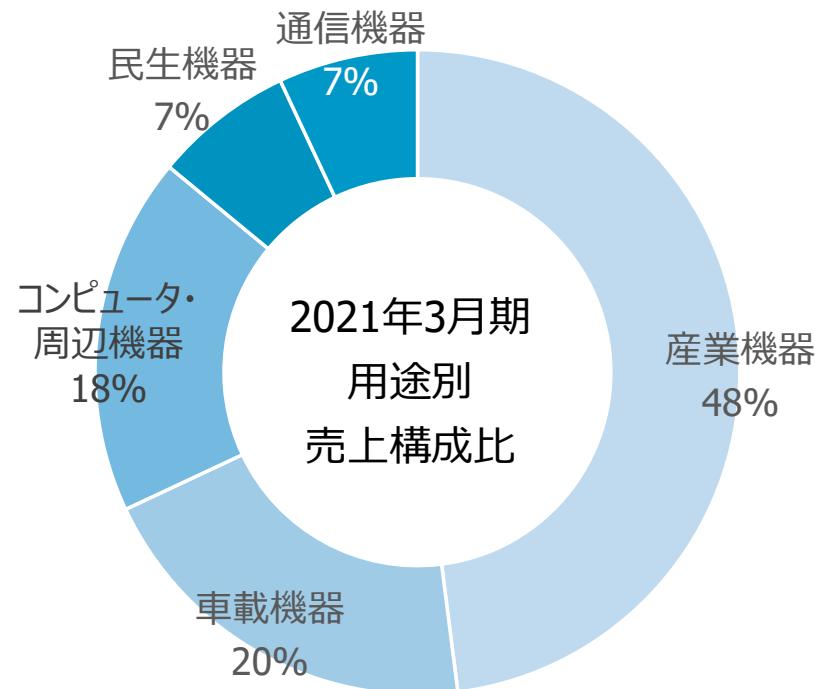
品目	主な商品
アナログIC	アナログIC
プロセッサ	マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、DSP
ロジックIC	画像処理用IC、通信・ネットワーク用IC、ASIC、PLD
メモリIC	フラッシュメモリ、SRAM / FRAM / MRAM
ボード・電子部品他	ボード、電源、光学部品
ソフトウェア・サービス	ソフトウェア、クラウドサービス
PB	設計・量産受託サービス、プライベートブランド製品

## 主な仕入先

- テキサス・インスツルメンツ社
- NXP Semiconductors
- インフィニオン テクノロジーズ
- インテル社
- マイクロソフト社

※主な仕入先は敬称を省略しております。

# 参考資料：EC事業 用途別売上構成比



用途	主な商品
産業機器	医療機器、FA機器、計測器 放送機器、ロボット
車載機器	カーリンフォテイメント 運転支援システム ボディーコントロールモジュール
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター（MFP/LBP/IJP） プロジェクタ、POSシステム サーバ/ストレージシステム
民生機器	AV機器 家庭用電気製品 デジタルカメラ
通信機器	スマートフォン/携帯電話 携帯基地局/伝送装置

# 参考資料：国内の主な専門商社



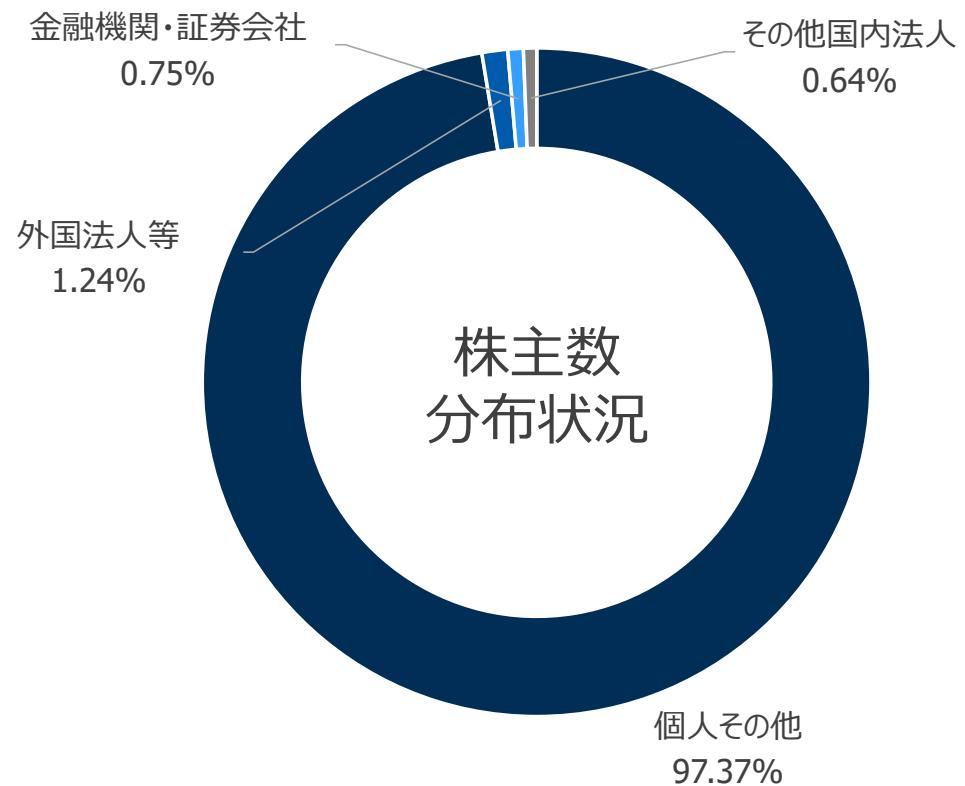
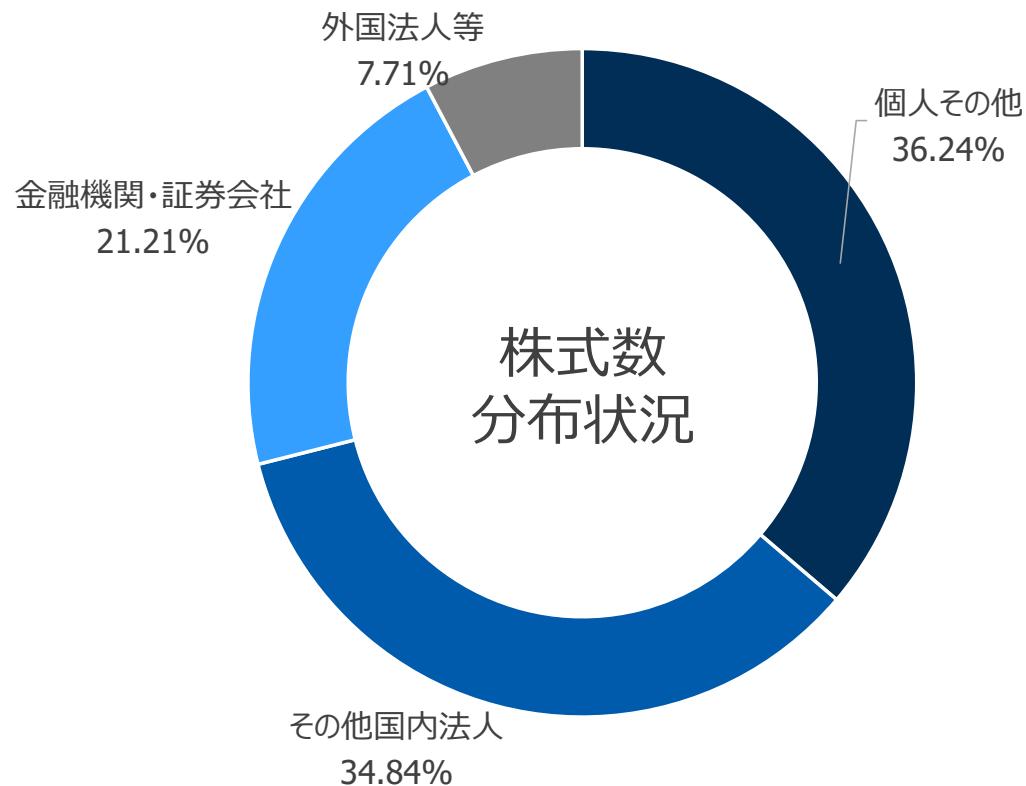
## エレクトロニクス

証券コード	社名	証券コード	社名
2715	エレマテック	8081	カナデン
2737	トーメンデバイス	8084	菱電商事
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	8137	サンワテクノス
3156	レスターホールディングス	8140	リヨーサン
7433	伯東	8141	新光商事
7467	萩原電気ホールディングス	8150	三信電気
7510	たけびし	8154	加賀電子
7537	丸文	8159	立花エレック

## 情報サービス

証券コード	社名	証券コード	社名
1973	NECネットエスアイ	4832	JFEシステムズ
2327	日鉄ソリューションズ	7518	ネットワンシステムズ
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	8056	日本ユニシス
3762	テクマトリックス	8096	兼松エレクトロニクス
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	9719	SCSK

# 参考資料：株式の状況



※ 2021年3月31日現在